

# 株式会社バイ・テクノロジー

## 2023年3月期 第2四半期決算

# 補足説明資料

2022年11月10日

# 将来見通し等について

## ▶ 将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

## ▶ 為替リスク

当社の主力製品である、半導体およびフラットパネルディスプレイ製造装置の輸出販売は、原則円建てで行われております。一部に外貨建て決済もありますが必要に応じて受注時に為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしております。従って、装置販売に関する為替レート変動による影響は軽微であります。

## ▶ 数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

## ▶ 報告セグメントの変更等に関する事項…【2023年3月期Q1より変更】

従来、当社グループの報告セグメントは「FPD事業」及び「半導体事業」を報告セグメントとしておりましたが、収益構造の変化に対し、経営上の管理区分の見直しを行ったことにより、当第1四半期連結会計期間より、「FPD装置事業」及び「半導体・フォトマスク事業」の区分に変更し、報告セグメントに含まれない事業セグメントを「その他」としてセグメント情報を開示しております。

なお、前連結会計期間のセグメント情報は、製品群見直し後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

# 連結業績サマリー

- ▶ FPD装置事業がパネル市況悪化の影響を受け、前年比減収減益

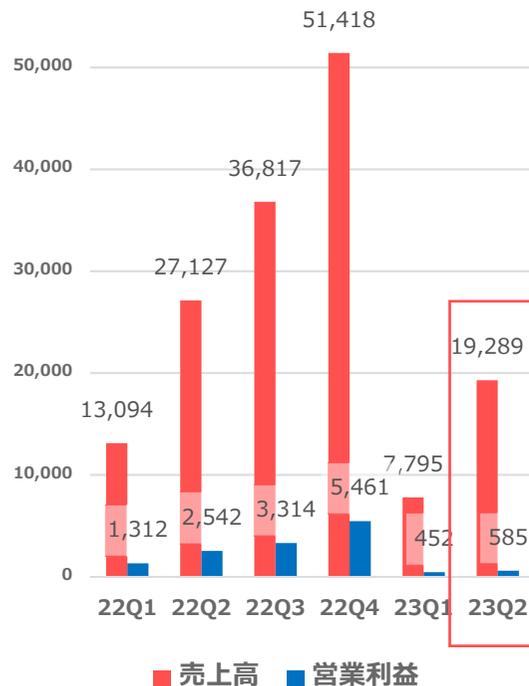
(百万円)	2022年3月期Q2		2023年3月期Q2		
	金額	構成比	金額	構成比	前年同期比
売上高	27,127	100.0%	19,289	100.0%	▲28.9%
売上総利益	7,309	26.9%	5,083	26.4%	▲30.5%
営業利益	2,542	9.4%	585	3.0%	▲77.0%
経常利益	2,462	9.1%	1,530	7.9%	▲37.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,893	7.0%	1,330	6.9%	▲29.8%

# 連結およびセグメント別売上高・営業利益の状況

(単位：百万円)

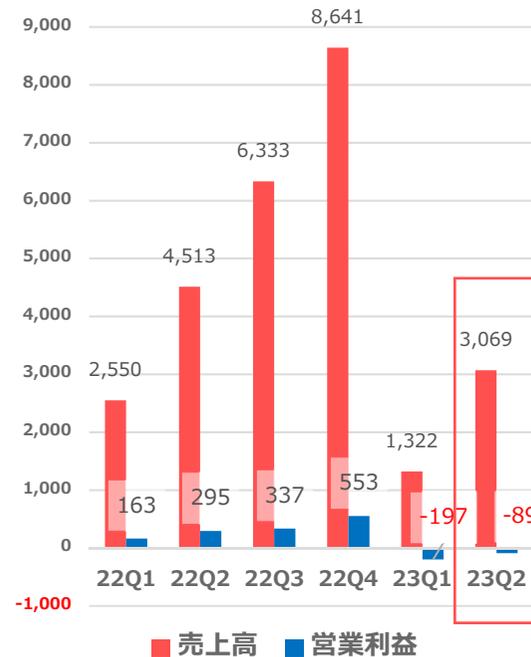
## 連結

	22年Q2	23年Q2	YoY
売上高(累計)	27,127	19,289	▲28.9%
営業利益(累計)	2,542	585	▲77.0%



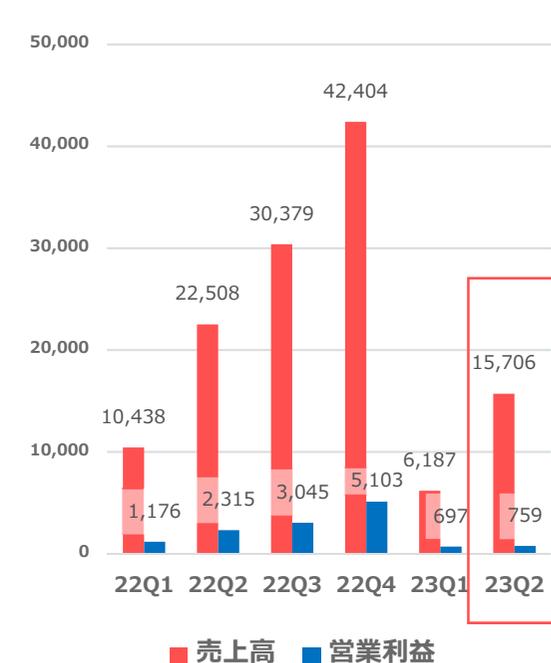
## 半導体・ フォトマスク

	22年Q2	23年Q2	YoY
売上高(累計)	4,513	3,069	▲32.0%
営業利益(累計)	295	▲89	—

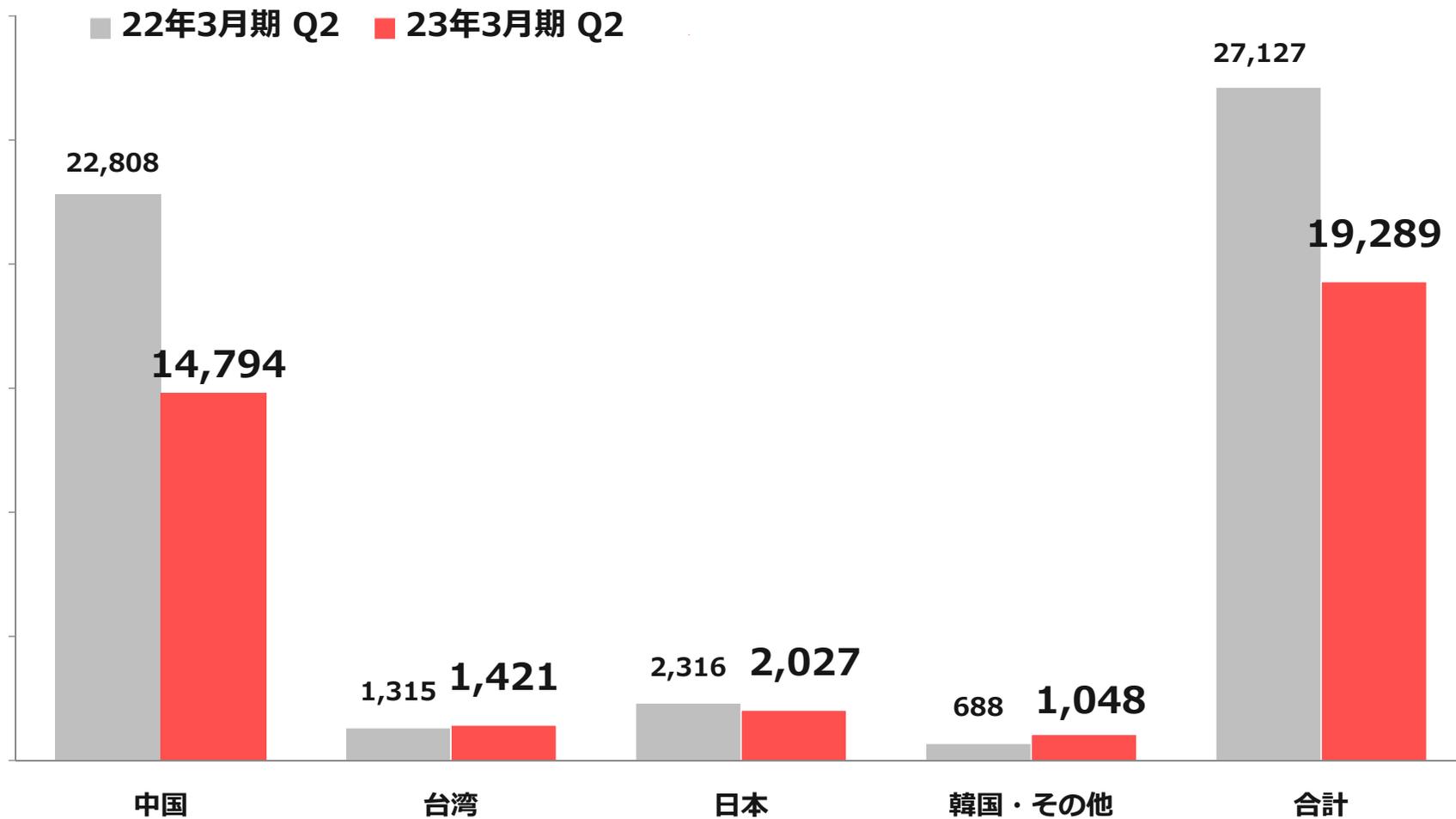


## FPD

	22年Q2	23年Q2	YoY
売上高(累計)	22,508	15,706	▲30.2%
営業利益(累計)	2,537	759	▲67.7%



## (参考) 地域別連結売上高 (単位: 百万円)



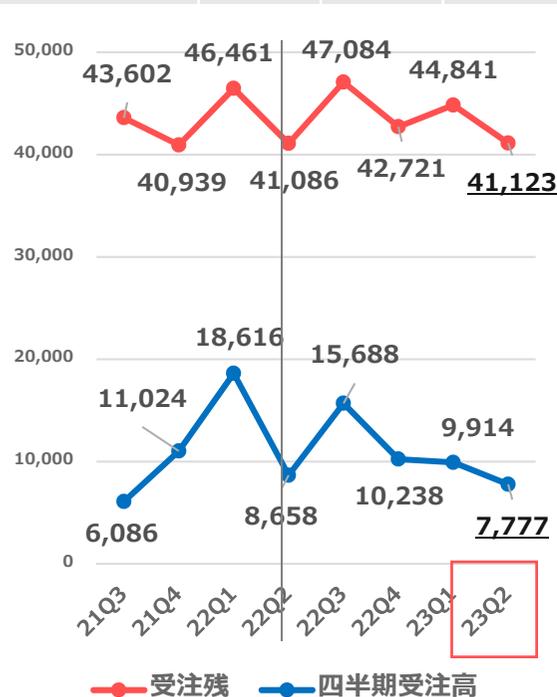
# 連結およびセグメント別の受注高・受注残の状況

(単位：百万円)

▶ 半導体・フォトマスク関連の受注増により収益構造改革が進展

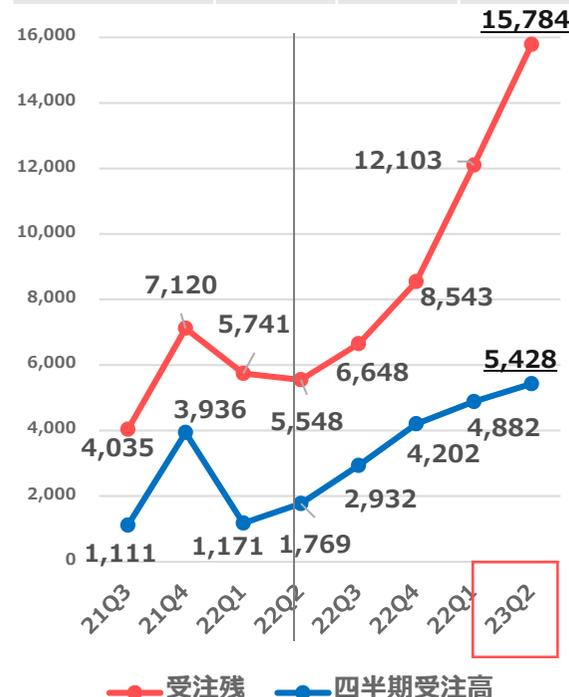
## 連結

	22年Q2	23年Q2	YoY
受注(3カ月)	8,658	7,777	▲10.2%
受注残	41,086	41,123	0.1%



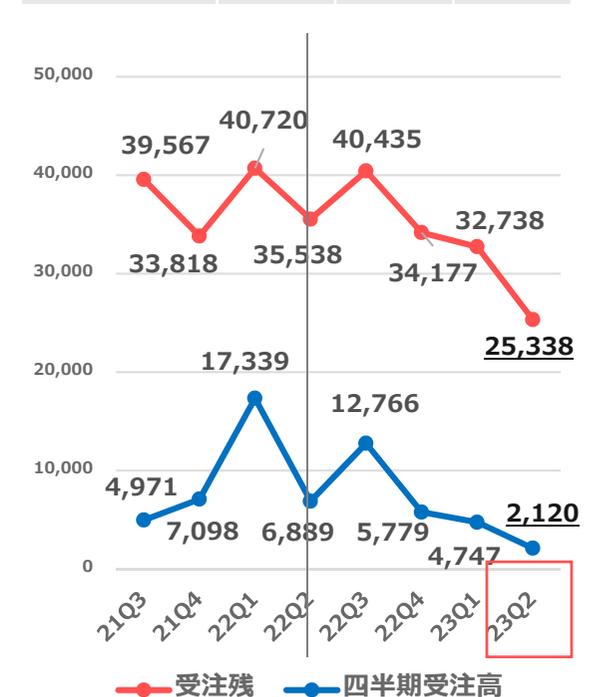
## 半導体・ フォトマスク

	22年Q2	23年Q2	YoY
受注(3カ月)	1,769	5,428	+206.8%
受注残	5,548	15,784	+184.5%

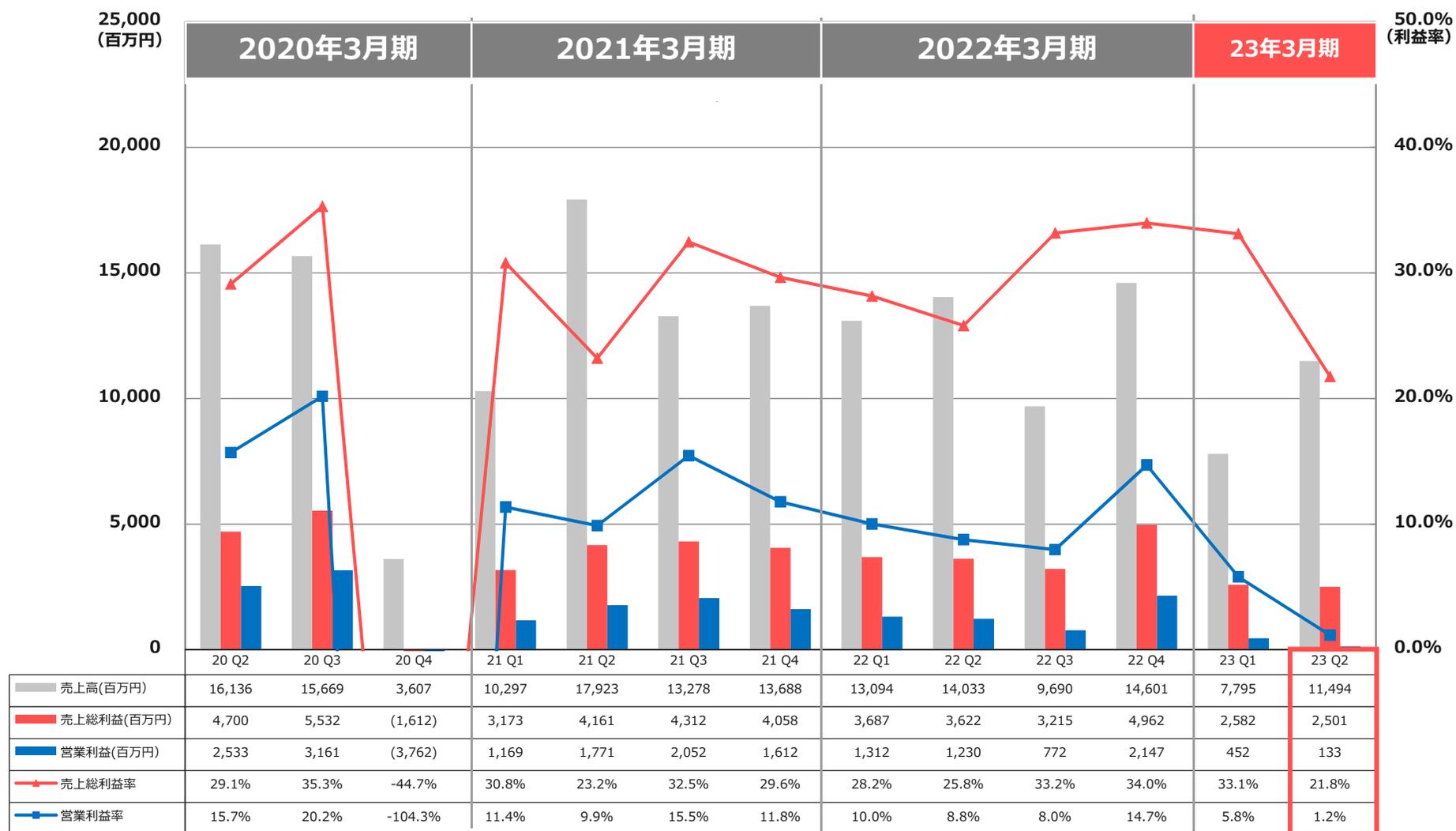


## FPD

	22年Q2	23年Q2	YoY
受注(3カ月)	6,889	2,120	▲69.2%
受注残	35,338	25,338	▲28.7%

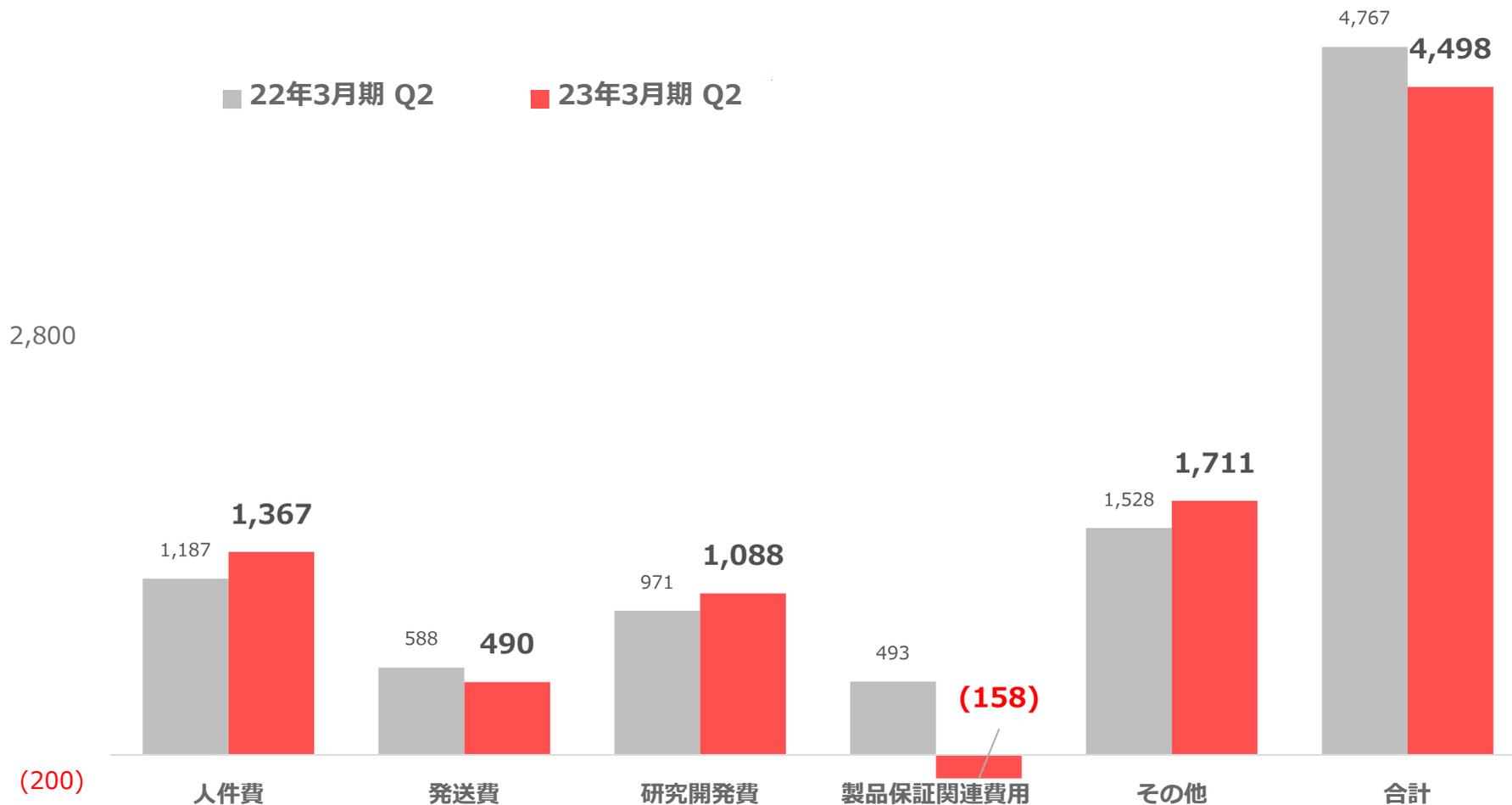


# (参考) 四半期毎連結売上高・利益の推移

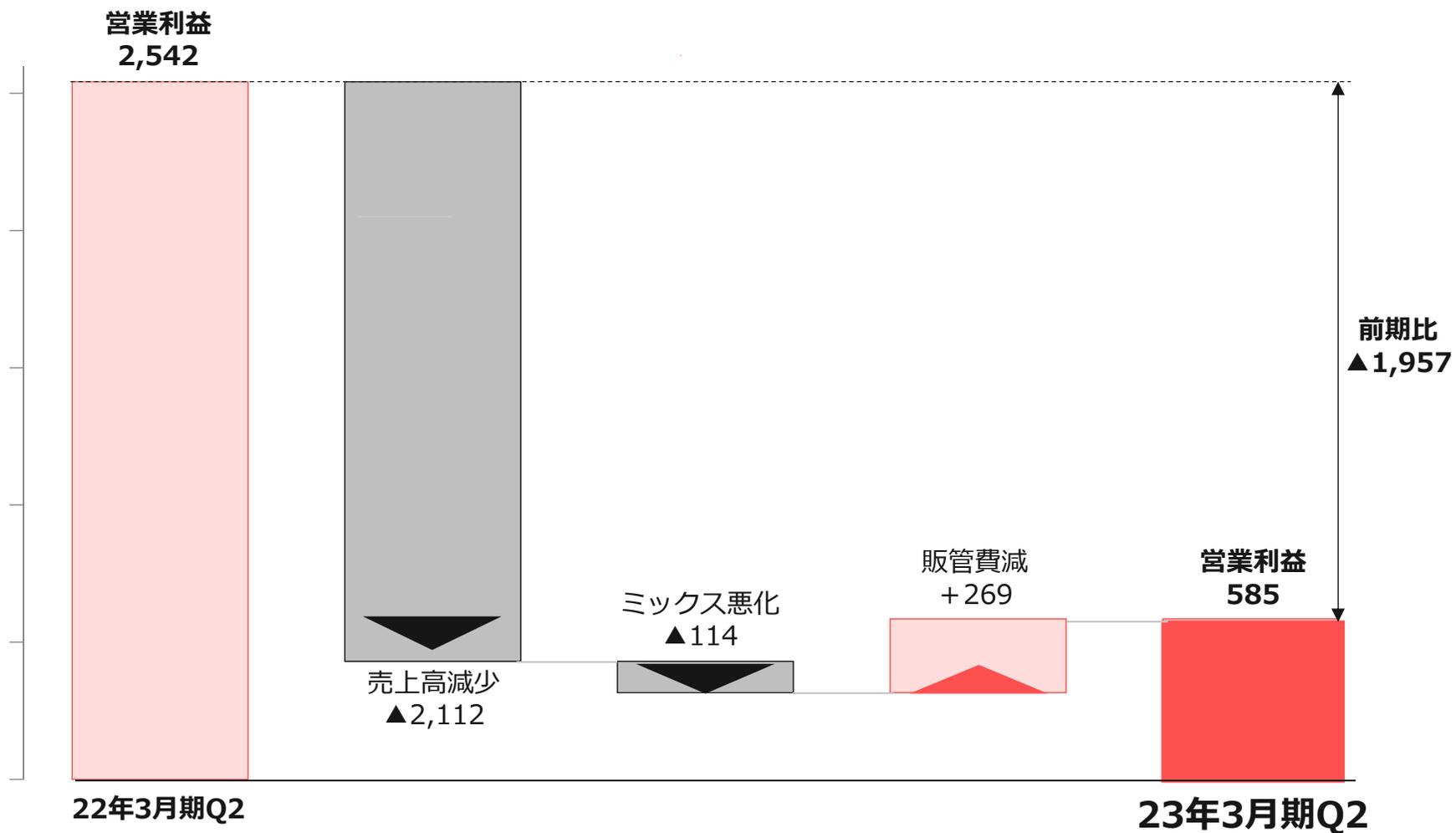


# 販売費及び一般管理費

(単位：百万円)



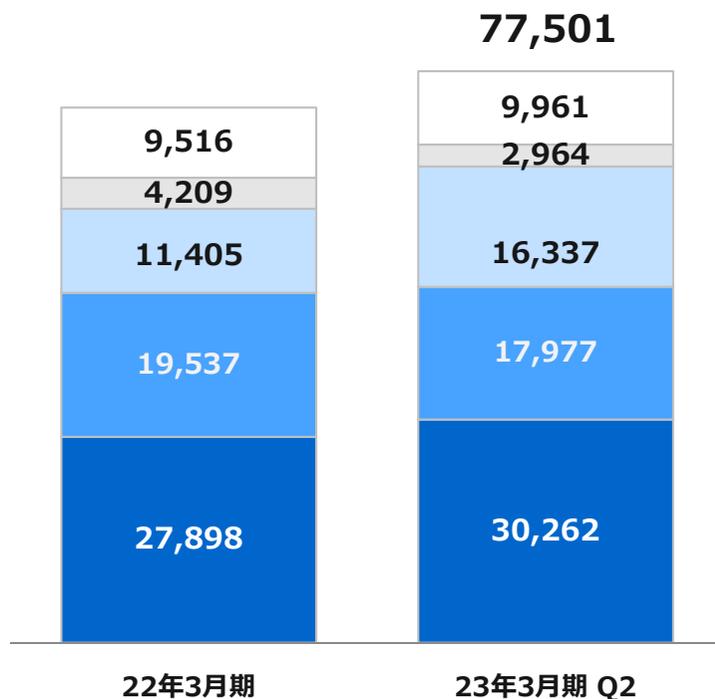
# (参考) 連結営業利益の差異分析 (単位: 百万円)



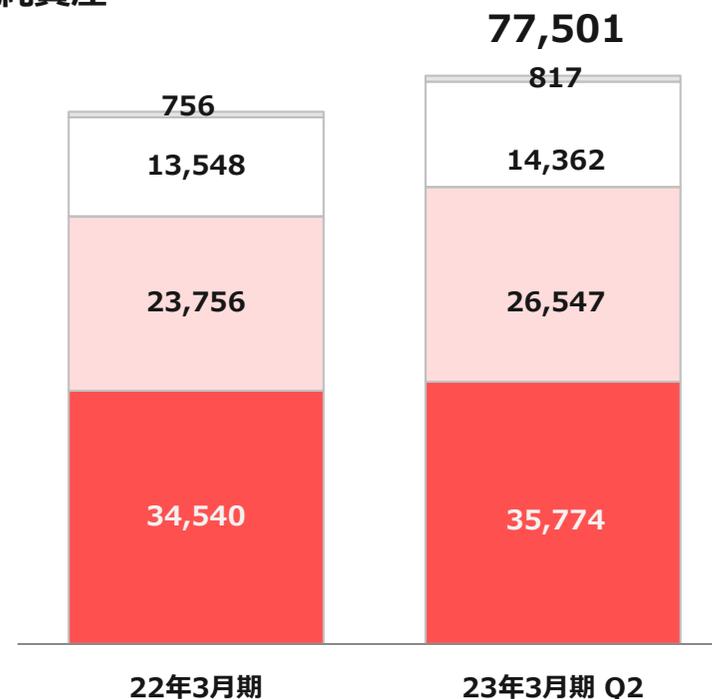
# 連結貸借対照表の推移 (単位：百万円)

- ① 棚卸資産 +4,932百万円：主に下期出荷製品の仕掛品の増加
- ② その他流動負債 +3,571百万円：主に前受金の増加(+2,893百万円)
- ③ 純資産 +1,234百万円：主に利益剰余金と為替換算調整勘定の増加

総資産



負債・純資産



■ 現金及び預金 ■ 受取手形及び売掛金 ■ 棚卸資産  
 ■ その他流動資産 ■ 固定資産

■ 純資産 ■ その他流動負債  
 ■ 借入金（短期・長期） ■ その他固定負債

# 連結キャッシュフロー

- ▶ 営業CF：純利益、前受金の増加および売上債権の減少等により2,090百万円
- ▶ 投資CF：有形固定資産の取得、子会社株式の取得等により▲422百万円
- ▶ 財務CF：長期借入金の増加等により42百万円

金額単位：百万円		22年3月期Q2	23年3月期Q2
営業活動による キャッシュフロー	税金調整前純利益	2,948	2,016
	売上債権（増加▲）	491	1,802
	棚卸資産（増加▲）	4,719	▲4,799
	仕入債務（減少▲）	11	770
	前受金（減少▲）	▲6,407	2,860
	その他	▲1,091	▲559
	<b>Total</b>	<b>671</b>	<b>2,090</b>
投資活動によるキャッシュフロー Total		<b>▲442</b>	<b>▲422</b>
財務活動による キャッシュフロー	借入による収入	70	2,552
	返済による支出	▲1,394	▲1,951
	その他	▲2,501	▲554
	<b>Total</b>	<b>▲3,825</b>	<b>42</b>
現金及び現金同等物に関わる換算差額		<b>30</b>	<b>648</b>
現金及び現金同等物の増減額（減少▲）		<b>▲3,656</b>	<b>2,364</b>
現金及び現金同等物の機首残高		<b>33,158</b>	<b>27,778</b>
現金及び現金同等物の四半期末残高		<b>29,593</b>	<b>30,142</b>

# | 通期業績及び配当の予想

## 通期業績及び配当予想を下方修正

- ▶ 業績予想：パネル市況の急激な悪化による顧客業績悪化と設備投資計画の延伸
  - 設備の納入・立上げの延期要請に対し、交渉を継続も要求を受けざるを得ず、通期販売計画を修正
  
- ▶ 配当予想：配当方針及び下期の業績見通しより期末の一株当たり配当額を30円減配

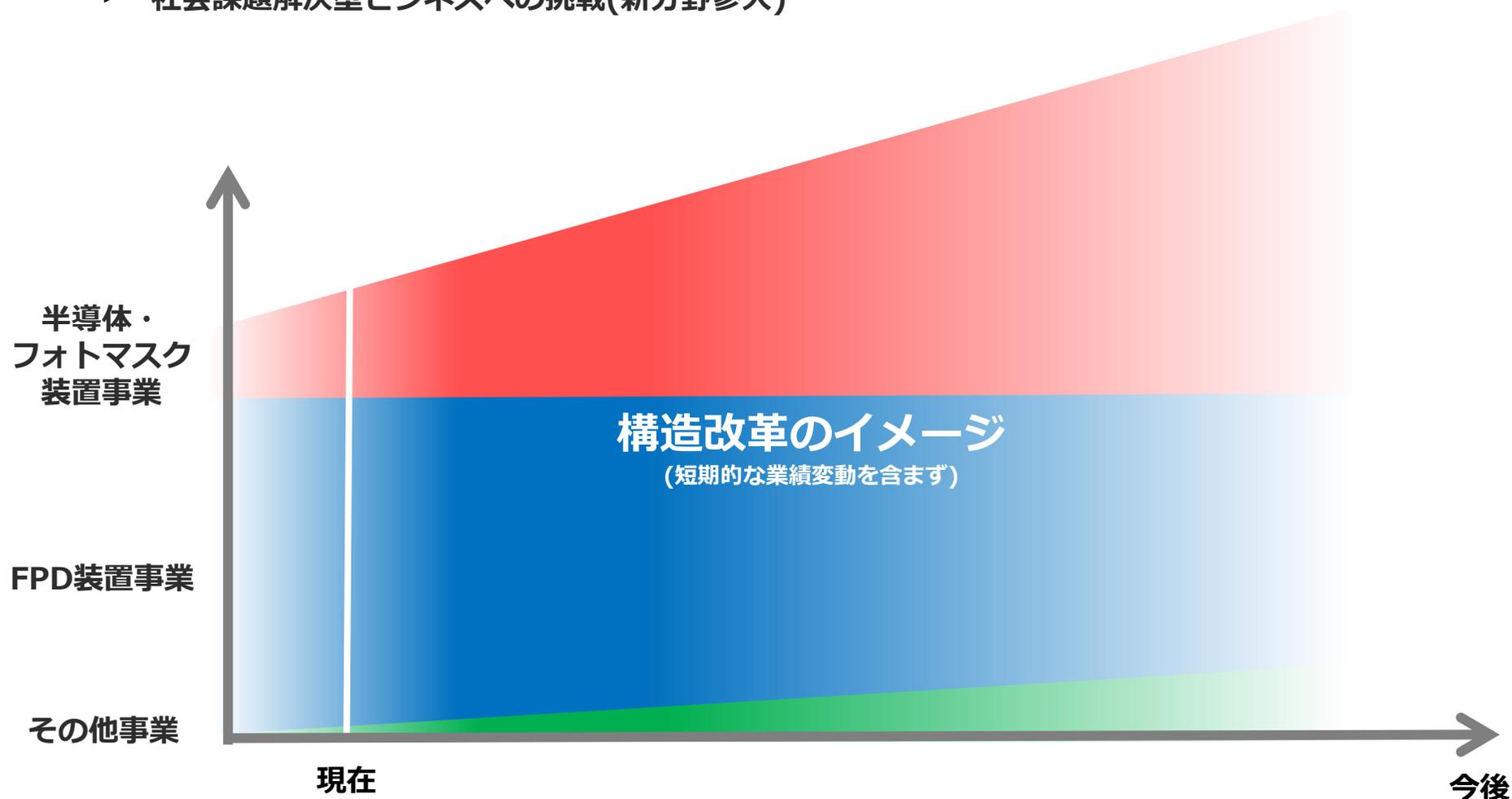
(百万円)	2022年3月期実績		2023年3月期業績予想					
	金額	構成比	旧予想(5月)		新予想(11月)			
			金額	構成比	金額	構成比	増減率	
							前期比	旧予想比
売上高	51,418	100.0%	45,000	100.0%	44,000	100.0%	▲14.4%	▲2.2%
営業利益	5,461	10.6%	4,500	10.0%	700	1.6%	▲87.2%	▲84.4%
経常利益	5,868	11.4%	4,400	9.8%	1,500	3.4%	▲74.4%	▲65.9%
親会社株主に帰属する当期純利益	4,198	8.2%	2,900	6.4%	1,200	2.7%	▲71.4%	▲58.6%
EPS(円)	434.21		299.92		124.10		—	—
配当(円)	中間	60円(実績)	60円		60円		—	—
	期末	60円(実績)	60円		30円		▲30円	▲30円

# 3. 今後の展望

— 更なる成長を目指して

# 収益構造の変革…基本方針に変更無

- ▶ 成長分野で新事業・新製品を立ち上げ、グループの持続的な成長を実現
  - ▶ 半導体・フォトマスク装置事業の成長促進
  - ▶ 収益基盤としてのFPD装置事業の安定化
  - ▶ 社会課題解決型ビジネスへの挑戦(新分野参入)



# 半導体・フォトマスク装置事業

## ▶ 事業環境

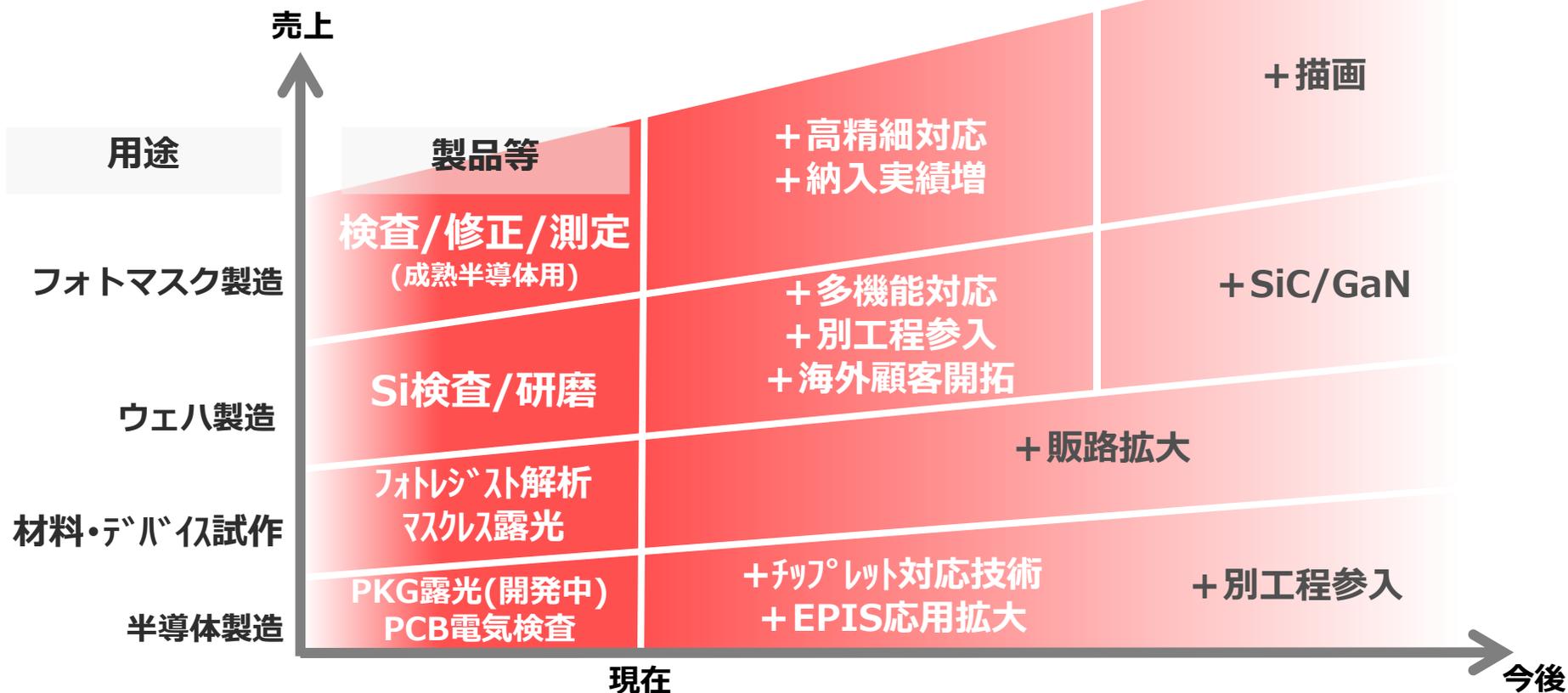
- ▶ 成熟半導体関連の装置需要は堅調さを維持
- ▶ **チップレット技術の革新**や**SiC/GaN半導体技術**等の動向に注目

## ▶ 成長施策等(製品別は下図参照)

- ▶ グループ内外と**共同開発**加速 + **M&Aによる外部事業取込**、**FPD人財の活用**、他

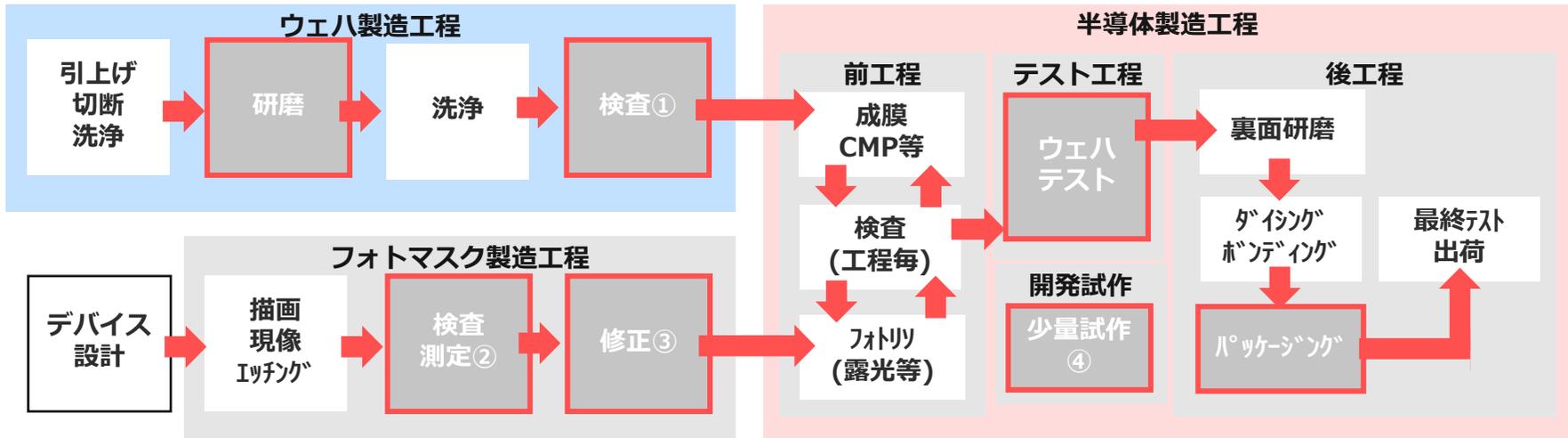
## ▶ 米国の対中輸出規制

- ▶ 現状は影響無し、地域・顧客に最適な**バリューチェーン**を柔軟に構築



# (参考)半導体製造工程を支える当社グループの製品

- ▶ 当社グループ製品の適用可能工程(下図赤枠)と、主要装置(①~④)
  - ▶ 技術開発・M&A・業務提携等によるシェア拡大への挑戦を継続



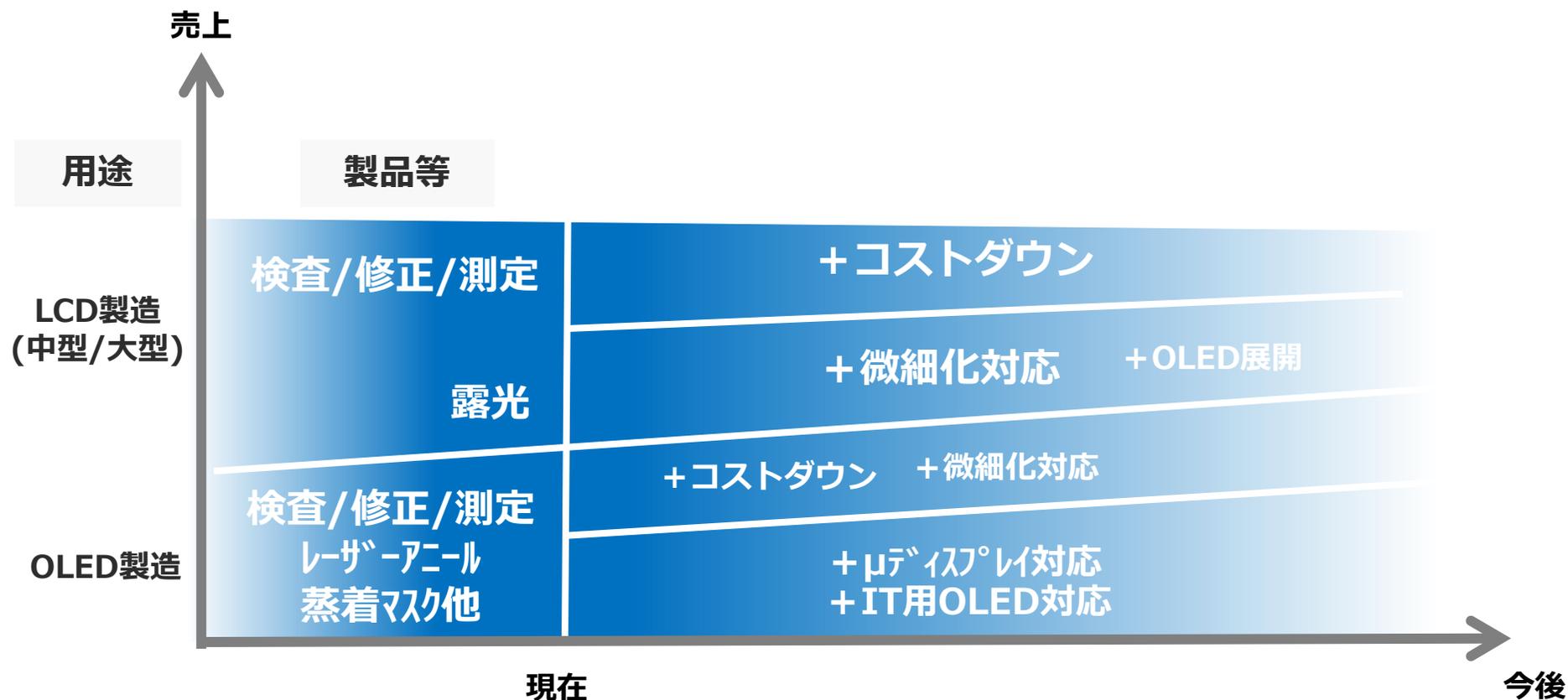
# FPD装置事業

## ▶ 事業環境

- ▶ **LCD設備需要減少**(LCDパネルの価格低迷継続、中国LCD設備補助金削減、ゼロロケ政策余波等)
- ▶ **OLED(IT用途等)やAR/VR用μディスプレイ関連投資**が中長期で装置需要を牽引

## ▶ 成長施策等

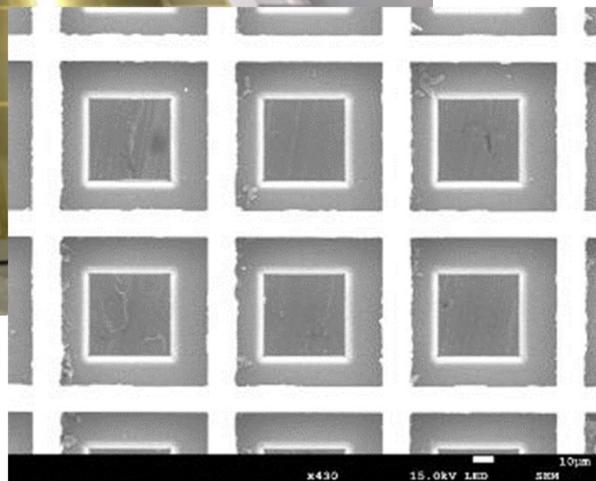
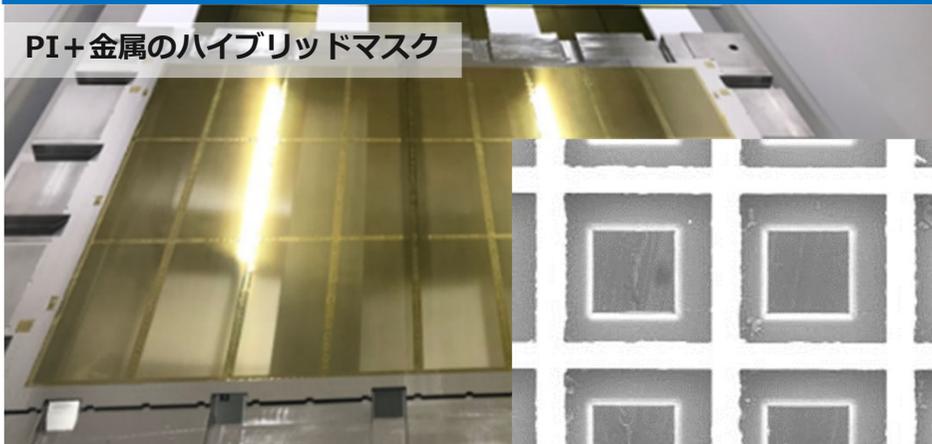
- ▶ LCD関連ではA/S現地化や基幹部品内製化等による各種コストの削減に注力
- ▶ OLEDやμディスプレイ関連技術の開発を粘り強く継続(**他社協業も推進**)



# FPD装置事業

## 蒸着マスク(FHM)

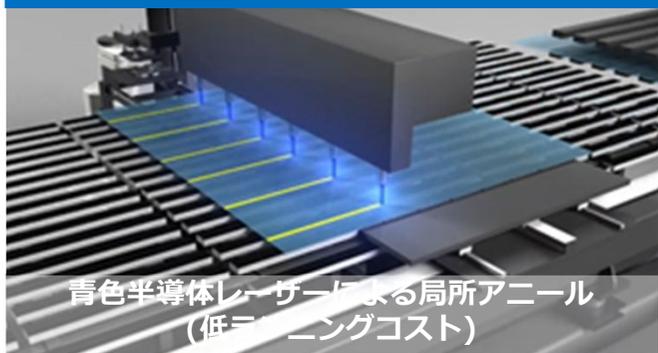
PI+金属のハイブリッドマスク



高精細かつ画素形状はフリー

各種用途にカスタマイズし易く設計自由度UP

## レーザーアニール装置



青色半導体レーザーによる局所アニール  
(低ランニングコスト)

		OLED TV	a-Si	BLDA
要求仕様 (電気特性面)	Mobility (cm <sup>2</sup> /VS)	>10	0.5	70-500
	Ion/Ioff	>10 <sup>7</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>7</sup>
	Vds(@3uA)	<5V	-	5-7V
	S-factor (V/decades)	0.5		0.2V
製造容易性		-	easy	easy
安定性	Life time	-	poor	good

優れた電気特性

## その他事業(社会課題解決型事業への挑戦)

- ▶ 持続的な中長期の成長を実現する為、異分野事業の立上げに挑戦
- ▶ 主要3分野における事業の状況(①~③)

### ① 農業

- ・ アイメック®農法によるトマト栽培事業
  - ・ 蘇州、横須賀、千葉で栽培開始
  - ・ 中国内ブランド名「陽香」
  - ・ 高糖度/高栄養価(リコピン他)
  - ・ 装置技術の農業展開
  - ・ 中国EC販売中、国内ECも予定



陽香



YRPイノベーションセンター



千葉ファーム

### ② 脱炭素

- ・ ネクスファイ・テクノロジー社へ資本参加
  - ・ SiCデバイスを用いた高圧電源技術に強み
  - ・ 半導体製造装置やEV/モーター検査用途
  - ・ 当社装置事業とのシナジー追求、他

### ③ IT

- ・ アイテック社を2月に完全子会社化(売上規模約10億円)
  - ・ 装置ソフトウェアの開発力強化
  - ・ 当社グループ内のIT関連業務の強化
  - ・ 事業拡大を視野に人員等のリソースを強化中

# YRPイノベーションセンター

## ▶ 生産と研究開発の拠点として初の自社工場

- ▶ Siウェハ検査装置、フォトマスク検査装置の製造拠点として8月より横須賀サ-パ-クで稼働開始
- ▶ **装置技術開発の他、農業技術開発に対応**





お問い合わせ先

社長室IRグループ  
[vtj-mng-pre@vtec.co.jp](mailto:vtj-mng-pre@vtec.co.jp)

